

概 要

本概要旨在向閣下提供本文件所載資料的概覽。由於此為概要，故並未列載所有可能對閣下屬重要的資料。閣下在決定投資[編纂]前，務請細閱整份文件。任何投資均有風險。有關投資[編纂]的部分特定風險載於本文件「風險因素」。閣下在決定投資[編纂]前，務請細閱該節。

概覽

我們為總部位於香港並在中國汕頭設有生產設施，專門從事開發、製造及銷售鍵合綫及封裝膠的知名半導體封裝材料製造商。我們的執行董事周教授(金紫荊星章、銀紫荊星章、銅紫荊星章、太平紳士)及執行董事兼執行主席周先生透過彼在振基電子集團積累的經驗、對電子材料的深入了解及技術知識，於2006年聯合創立本集團。周教授為周先生之父。具體而言，周教授自20世紀80年代投身電子材料行業，積累逾36年經驗。在周教授及周先生的領導下，我們於2010年首次取得中國高新技術企業這一殊榮。於2016年，我們被中國國家知識產權局評為國家知識產權優勢企業。根據弗若斯特沙利文報告，按銷售收益計，我們於2017年於中國所有鍵合綫製造商及所有中國品牌鍵合綫製造商中分別排名第七及第二，市場份額約達1.5%。根據弗若斯特沙利文報告，按2017年在中國的銷售收益計，我們亦為香港最大的鍵合綫製造商。

我們的主要產品類別鍵合綫及封裝膠為製造廣泛用於終端市場為消費電子產品的LED及IC的各項封裝技術常用的重要材料。LED及IC(各為半導體的主要類型)通常用於照明及各類消費電子產品(如智能手機及平板電腦、多媒體設備、個人及筆記本電腦及其他物聯網及消費電子設備)。於往績記錄期間，我們已開發出逾100種符合客戶規格及質量標準的不同規格的多元化產品組合，該等產品具備不同的力學、熱學、光學、電學及化學性能指標。為符合國際及中國標準，我們的全部產品符合RoHS指令。我們的主要產品類別的一般描述如下：

- (i) 鍵合綫—我們研發、製造及供應金、金合金、銀合金、鋁、硅鋁、銅、銅合金及鍍鈀銅等精細及超精細的鍵合綫。我們的鍵合綫直徑介乎0.7毫米至3.2毫米，具有抗腐蝕，合金成分均勻及機械性能穩定等性能。鍵合綫表面光滑整潔，鍵合可靠性高；
- (ii) 封裝膠—我們的封裝膠主要包括(a)用於COB封裝的高純液態COB環氧樹脂封裝膠；(b)用於室內及戶外LED封裝具有低粘度、耐紫外光及耐高溫特性的LED環氧樹脂；(c)用於LED照明、背光及燈絲具有強粘性、中等強度及高熱穩定性的LED封裝硅膠；及(d)固晶膠；及
- (iii) 其他產品—主要包括主要用於PCB的錫線、錫條、焊錫膏及鍵合工具。

概 要

下表載列於往績記錄期間按產品種類劃分的主要財務及營運數據：

產品種類	2015財政年度			2016財政年度			2017財政年度			單位售價 範圍 港元
	收益 千港元	佔收益% %	單位售價 範圍 港元	收益 千港元	佔收益% %	單位售價 範圍 港元	收益 千港元	佔收益% %	單位售價 範圍 港元	
鍵合綫										
金綫	67,969	61.7	1,271-11,432	91,774	58.7	1,198-5,388	80,538	44.6	1,380-5,335	
金銀合金綫	10,322	9.4	88-2,607	35,713	22.8	80-2,574	60,033	33.2	79-2,574	
銅基綫	5,441	5.0	21-321	5,845	3.8	26-189	7,355	4.1	32-197	
鉛基綫	3,433	3.1	42-310	3,042	1.9	39-269	3,052	1.7	39-260	
	<u>87,165</u>	<u>79.2</u>		<u>136,374</u>	<u>87.2</u>		<u>150,978</u>	<u>83.6</u>		
封裝膠										
COB環氧樹脂封裝膠 (附註1)	10,169	9.2	47-1,432	8,570	5.5	44-1,335	9,223	5.1	39-1,321	
LED環氧樹脂	-	-	-	684	0.4	149-847	4,299	2.4	148-838	
LED封裝硅膠	1,842	1.7	235-908	974	0.6	169-847	3,346	1.9	81-493	
	<u>12,011</u>	<u>10.9</u>		<u>10,228</u>	<u>6.5</u>		<u>16,868</u>	<u>9.4</u>		
其他產品 (附註2)	<u>10,949</u>	<u>9.9</u>		<u>9,807</u>	<u>6.3</u>		<u>12,676</u>	<u>7.0</u>		
總計	<u><u>110,125</u></u>	<u><u>100.0</u></u>		<u><u>156,409</u></u>	<u><u>100.0</u></u>		<u><u>180,522</u></u>	<u><u>100.0</u></u>		

	2015財政年度				2016財政年度				2017財政年度			
	銷量 千米/ 公斤	毛利 千港元	佔毛利% %	毛利率	銷量 千米/ 公斤	毛利 千港元	佔毛利% %	毛利率	銷量 千米/ 公斤	毛利 千港元	佔毛利% %	毛利率
鍵合綫	221,496	13,286	58.7	15.2	245,036	26,608	81.0	19.5	280,746	29,932	79.5	19.8
封裝膠	123,303	7,237	32.0	60.3	125,531	4,697	14.3	45.9	158,169	6,157	16.3	36.5
其他產品 (附註2)	2,099	2,099	9.3	19.2	1,549	1,549	4.7	15.8	1,591	1,591	4.2	12.5
總計	<u><u>222,622</u></u>	<u><u>22,622</u></u>	<u><u>100.0</u></u>	<u><u>20.5</u></u>	<u><u>32,854</u></u>	<u><u>32,854</u></u>	<u><u>100.0</u></u>	<u><u>21.0</u></u>	<u><u>37,680</u></u>	<u><u>37,680</u></u>	<u><u>100.0</u></u>	<u><u>20.9</u></u>

附註：

1. 此產品類別包括銷售固晶膠應佔收益。
2. 此產品類別包括錫線、錫條、焊錫膏及鍵合工具。由於涉及不同類型的產品及貨品，並無統一的單位可用於公平量化單位售價或銷量。

我們的收益由2015財政年度約110.1百萬港元增加約42.1%至2016財政年度約156.4百萬港元，主要由於鍵合綫（尤其是金銀合金綫及金綫）的銷售額增加，被銷售封裝膠的收益減少所抵銷。我們銷售封裝膠的收益減少主要由於(i)我們的主要封裝膠產品COB環氧樹脂封裝膠的平均售價下跌，乃由於需求減少，尤其是電子玩具客戶的需求減少；及(ii)銷售LED照明、背光及燈絲以及室內及戶外RGB LED顯示屏等用途的LED環氧樹脂及LED封裝硅膠貢獻的收益佔比很少，具體而言，用於LED燈絲及LED環氧樹脂的若干LED封裝硅膠產品分別於2015年及2016年下半年首次推出，當時僅處於始銷階段。

概 要

我們的收益進一步增加約15.4%至2017財政年度約180.5百萬港元，主要由於(i)鍵合綫(尤其是金銀合金綫及金綫)；及(ii)封裝膠(尤其是LED環氧樹脂及LED封裝硅膠)的銷售增加。

於往績記錄期間，我們的整體毛利率保持穩定，分別為約20.5%、21.0%及20.9%。鍵合綫的毛利率由2015財政年度約15.2%提高至2016財政年度約19.5%，主要由於利潤率相對較高的金銀合金綫及金綫的銷售增加。於2017財政年度，鍵合綫的毛利率保持穩定，為約19.8%。封裝膠的毛利率由2015財政年度約60.3%減至2016財政年度約45.9%，並進一步減至2017財政年度約36.5%。毛利率下降主要由於(i)銷售COB環氧樹脂封裝膠的平均售價因需求(尤其是電子玩具客戶的需求)減少而整體下降；及(ii)較新的封裝膠產品的資本化攤銷成本增加。

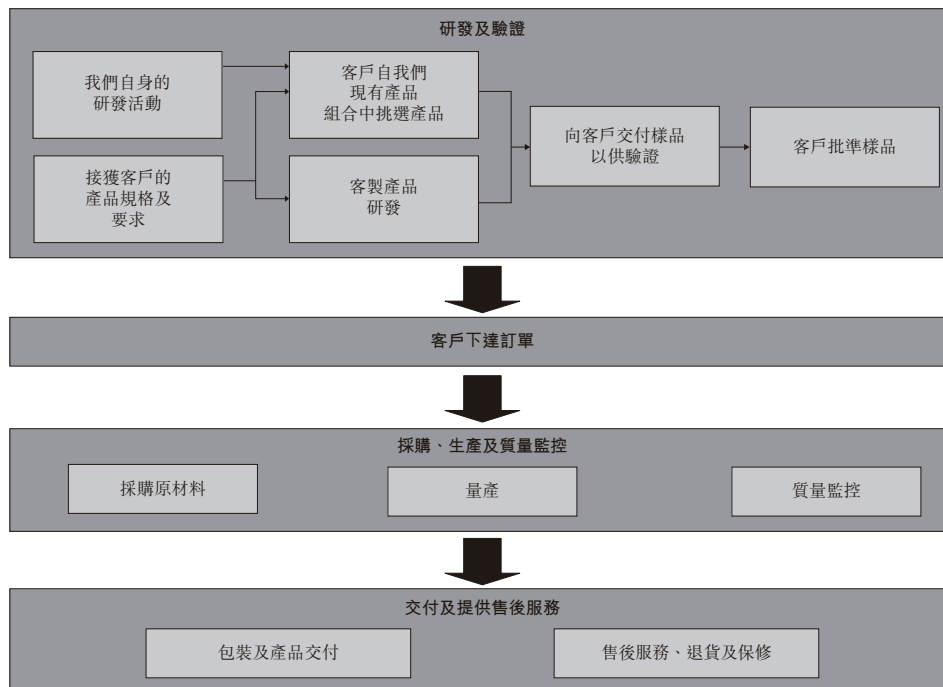
就封裝膠而言，鑒於正面的行業前景及市場潛力，我們目前計劃專注於LED環氧樹脂及LED封裝硅膠，尤其是不同用途(如農業、醫療、景觀、廣告、舞台及其他應用)的LED產品的封裝。於2015財政年度及2016財政年度，LED環氧樹脂及LED封裝硅膠各自處於初期始銷階段，因此，董事認為LED環氧樹脂及LED封裝硅膠於相關期間的財務表現並非其未來盈利能力的可靠及有意義的指標。於2017財政年度，儘管LED封裝硅膠的平均單位售價因推出成本較低的LED封裝硅膠而於2017財政年度下跌，我們銷售LED環氧樹脂及LED封裝硅膠的收益及毛利較2016財政年度顯著增長，增幅約361.1%及521.1%。尤其是，2017年下半年(即我們傳統的旺季)，銷售LED環氧樹脂及LED封裝硅膠的收益較2017年上半年分別大幅增長約1,151.9%及142.1%。來自銷售LED環氧樹脂及LED封裝硅膠錄得毛利約2.6百萬港元(而於2017年上半年錄得毛損約0.1百萬港元)，增長約2,700%。該增長主要由於平均售價上漲約73.3%，且2017年下半年LED環氧樹脂及LED封裝硅膠的銷量較2017年上半年增加約182.7%。於2017年下半年，LED環氧樹脂的毛利率為約39.0%，而於2017年下半年，LED封裝硅膠的毛利率為約42.4%。董事認為，因應現有及潛在客戶需求增加及受惠於過渡期後的規模經濟效益提升，LED環氧樹脂及LED封裝硅膠的毛利率將繼續提升。

經考慮(i)透過我們對LED環氧樹脂、LED封裝硅膠及其他封裝膠產品的不斷研發能力，並掌握最新的行業趨勢及客戶產品規格要求；(ii)我們封裝膠產能擴張計劃及規模經濟帶來的利益；及(iii)我們的其他業務策略及競爭優勢以及優良往績，董事認為我們有能力應付不同終端市場對封裝膠的需求。詳情請參閱本文件「業務－競爭優勢」及「業務－業務策略」。

概 要

我們的業務模式

於往績記錄期間，本集團約93.7%、95.8%及96.4%的收益主要來自中國客戶，而本集團餘下6.3%、4.2%及3.6%的收益來自香港客戶。以下圖表列示我們的營運業務模式：



更多詳情請參閱本文件「業務－我們的業務模式」。

研發

我們於汕頭的生產設施建立研發中心。於最後實際可行日期，我們已將總部遷往香港科學園，我們的總部會用於在香港進行客戶支援、銷售及市場拓展、策略及業務發展以及研發活動。於2017年12月31日，我們的研發中心配有一支由48名研發及工程專業人員組成的團隊。於往績記錄期間，我們的研發活動主要於研發中心進行，其為獲廣東省政府唯一認可的半導體及微電子材料工程技術研發中心及汕頭電子封裝材料工程技術研發中心。有關詳情，請參閱本文件「業務－研發」。有關研發開支入賬的資料，參閱本文件「財務資料－重要會計政策及估計－無形資產－內部產生無形資產－研發開支」。於最後實際可行日期，我們已於中國及台灣註冊35項專利並於中國申請另外27項專利。

生產設施

我們於中國廣東省汕頭市建立生產設施。我們位於汕頭生產設施中的生產線總建築面積約777.1平方米，設有1,000級無塵室、10,000級無塵室及100,000級無塵室。於最後實際可行日期，我們設有三條製造鍵合綫的生產線及兩條在營封裝膠生產線。於往績記錄期間，鍵合綫生產設施的實際使用率分別為約79.3%、99.6%及96.8%，而封裝膠生產設施的實際使用率分別為約82.4%、80.3%及88.7%。

概 要

我們目前正在安裝兩條總設計年產能約為242,000公斤的新增封裝膠生產線。董事擬安裝該等新增封裝膠生產線，從而令COB環氧樹脂封裝膠、LED環氧樹脂、LED封裝硅膠及固晶膠各自將擁有專門的生產線。鑒於(a)封裝膠，尤其是LED環氧樹脂及LED封裝硅膠的市場前景廣闊；(b)收入增長由(其中包括)2017財政年度封裝膠的銷售額所推動，主要由於LED環氧樹脂及LED封裝硅膠平均售價及銷量於2017年下半年旺季的增加；(c)於2018財政年度及2019財政年度，現有及潛在客戶因不具法律約束力的諒解備忘錄提出的指示性訂單；(d)現有封裝膠生產設施的利用率高；及(e)擴充產能及提高生產效率對我們應付任何採購訂單規模及／或數量增長的能力至關重要，董事認為，封裝膠產能擴充計劃實屬必要，其讓我們(i)把握LED環氧樹脂及LED封裝硅膠新湧現的商機，尤其是各種LED封裝應用帶來的商機；(ii)各類主要產品擁有專門生產線可消除改造生產設施的機器閒置時間；及(iii)通過避免不同材料交叉混合造成的產品污染，提高產品質量。

其中一條新增封裝膠生產線亦於2017年10月開始試運行及預期將於2018年上半年開始商業化生產。另一條新增的封裝膠生產線預期於2018年第二季度末開始試運行及於2018年下半年開始商業化生產。正在進行中的產能擴充完成後，兩條現有封裝膠生產線的用途將調整，從而令COB環氧樹脂封裝膠、LED環氧樹脂、LED封裝硅膠及固晶膠各自擁有專門的生產線。

為確保優質硅材的持續供應以支持LED封裝硅膠的生產擴充，我們亦透過建立一條設計年產能約55,000公斤的生產線就硅材生產進行上游整合。硅材生產線於2017年10月開始試運行，及董事預期將於2018年上半年開始商業化生產。

除該三條新增生產線外，我們將繼續通過安裝另外兩條設計年產能合共約479,000千米的主要用於製造金銀合金綫的鍵合綫生產線，選擇性擴充產能及升級生產設施。有關詳情參閱本文件「業務－業務策略」及「業務－生產設施－產能擴充」。

供應商

我們主要向中國、美國及台灣逾100名供應商直接採購材料，包括貴金屬(如黃金及銀)及其他非貴金屬(如銅及鋁)、環氧樹脂及硅樹脂以及其他化學物。此外，我們亦採購成品進行買賣。於往績記錄期間，自五大供應商的採購額分別為約68.1百萬港元、102.5百萬港元及105.5百萬港元，分別佔總採購額約85.4%、84.5%及80.9%，而自最大供應商的採購額分別為約52.2百萬港元、64.0百萬港元及48.4百萬港元，分別佔同期總採購額約65.4%、52.7%及37.1%。直至最後實際可行日期，我們與往績記錄期間的五大供應商大都建立介乎四至六年的業務關係。有關於往績記錄期間使用的原材料成本的波動的敏感度分析，參閱本文件「財務資料」。

概 要

客戶

我們向超過300名客戶(包括主要位於中國的知名LED、相機模組及IC製造商)直接銷售產品。於往績記錄期間，我們對五大客戶的銷售額分別為約73.2百萬港元、100.5百萬港元及95.3百萬港元，分別佔收益約66.5%、64.3%及52.7%，而我們對最大客戶的銷售額分別為約37.0百萬港元、42.7百萬港元及50.8百萬港元，分別佔同期收益約33.6%、27.3%及28.1%。直至最後實際可行日期，我們與往績記錄期間部分五大客戶建立逾五年的業務關係。

於往績記錄期間，我們開發逾100種符合客戶規格及質量標準且具備不同的力學、熱學、光學、電學及化學性能指標的不同規格及材料成分的多元化產品組合，故鍵合綫及封裝膠的單位售價範圍較廣。

有關我們定價政策的詳情，參閱本文件「業務－銷售、客戶及營銷－定價策略」。

競爭優勢

我們認為，下列競爭優勢造就了我們的成功，讓我們於競爭對手中脫穎而出：(i)我們於中國鍵合綫行業的穩固地位讓我們爭取鍵合綫及封裝膠於LED應用中的機會；(ii)強大的研發能力、豐富的技術專業知識以及先進的生產設施；(iii)客源龐大，並與其建立長期合作的業務關係；及(iv)往績斐然、經驗豐富及盡職盡責的管理層團隊。有關優勢的更多詳情，請參閱本文件「業務－競爭優勢」。

策略

我們的目標為通過推行以下策略成為中國領先的半導體封裝材料製造商：(i)策略性擴充產能及升級生產設施；(ii)繼續於新產品及應用、原材料及生產技術方面投放研發資源；(iii)增加銷售及營銷活動以推廣產品及提升公司形象；及(iv)進行戰略收購及投資。有關策略的更多詳情，請參閱本文件「業務－業務策略」。

融資安排

直至2017年7月25日，我們與振基電子集團匯集財務資源及銀行借貸，據此，我們的全資附屬公司駿碼科技(香港)(於重組前亦為振基電子集團當時的間接全資附屬公司)自兩家商業銀行取得貸款以應付我們的資金需求及為業務營運提供資金。隨後，駿碼科技(香港)將現金盈餘(包括銀行借款資金、可用現金資源及／或經營所產生現金流)匯回振基電子集團，以供集中管理，從而促進振基電子集團內部更有效使用資金。根據該現金匯集安排，我們自銀行借款產生利息開支，亦向振基電子集團收取盈餘現金匯款的利息。若干該等銀行融資包含交叉擔保。為籌備[編纂]，於2017年7月，有關分擔銀行融資及為銀行借款提供擔保的有關安排已終止及解除。為說明我們在現金匯集安排並不存在的假定情況下的財務表現，倘不計入名義開支、未繳住房及社會保險供款以及潛在的最高罰款及罰金，我們於往績記錄期間的經調整(虧損)／溢利淨額分別為約(0.9)百萬港元、4.6百萬港元及11.3百萬港元，導致與我們同期的純利(不計及[編纂])相比分別產生差額約(4.8)百萬港元、(6.1)百萬港元及(1.4)百萬港元。

概 要

綜合財務資料概要

經選定綜合損益及其他全面收益項目

	2015 財政年度 千港元	2016 財政年度 千港元	2017 財政年度 千港元
收益	110,125	156,409	180,522
毛利	22,622	32,854	37,680
年度溢利	3,888	9,920	1,992
非香港財務報告準則計量			
純利(不計及[編纂]) ⁽¹⁾	3,888	10,743	12,703
經調整(虧損)/溢利淨額 ⁽²⁾	(1,573)	3,860	10,005

附註：

- 此為非香港財務報告準則計量。參閱本文件「財務資料－經營業績」。
- 年度經調整(虧損)/溢利淨額乃經計及(i)基於往績記錄期間按我們在終止現金匯集安排後所取得的新銀行融資項下授出的最高實際利率取得的作自用的估計銀行借款計算的本集團的估計利息開支，經扣除應收關連方款項的利息收入及所獲得的銀行借款總額的利息開支；(ii)先前位於觀塘之辦公室的名義辦公室租金；(iii)未繳住房公積金及社會保險供款；及(iv)與於往績記錄期間的租賃相關不合規事件有關之潛在最高罰款及處罰後基於年度純利(不計及[編纂])計算。此為非香港財務報告準則計量。參閱本文件「財務資料－經營業績」。
有關中國法律顧問對未繳住房及社會保險供款的風險的意見基準，參閱本文件「財務資料－經營業績」及「業務－物業」。

經選定綜合資產負債表項目

	於12月31日		
	2015年 千港元	2016年 千港元	2017年 千港元
非流動資產	75,081	73,605	94,777
流動資產	217,044	208,702	97,308
流動負債	177,000	126,832	38,299
流動資產淨值	40,044	81,870	59,009
資產淨值	103,340	105,159	143,084
權益總額	103,340	105,159	143,084

經選定綜合現金流量項目

	2015 財政年度 千港元	2016 財政年度 千港元	2017 財政年度 千港元
經營活動所得/(所用)現金淨額	14,124	(18,192)	(3,177)
—營運資金變動前經營現金流量	7,274	17,040	11,154
投資活動(所用)/所得現金淨額	(114,415)	34,925	112,689
融資活動所得/(所用)現金淨額	107,732	(20,617)	(106,512)
現金及現金等價物增加/(減少)淨額	7,441	(3,884)	3,000
外幣匯率變動的影響	(345)	(323)	77
年初現金及現金等價物	4,792	11,888	7,681
年末現金及現金等價物	11,888	7,681	10,758

概 要

我們的流動資產淨值由2015年12月31日約40.0百萬港元增加約41.9百萬港元至2016年12月31日約81.9百萬港元。增加主要由於(i)貿易應收款項因銷售表現於2016財政年度改善而增加及(ii)償還銀行借款，部分被結算應收關連公司款項所抵銷。我們的流動資產淨值減少約22.9百萬港元至2017年12月31日的59.0百萬港元，主要由於於2017年7月通過發行新股份結算銀行借款。進一步詳情，請參閱本文件「財務資料－融資安排」。

於往績記錄期間，本集團於2016財政年度及2017財政年度錄得經營現金流出淨額約18.2百萬港元及3.2百萬港元，主要由於截至2016年及2017年12月31日貿易應收款項及應收票據大幅增加，主要由於臨近2016財政年度及2017財政年度結束時接獲的銷售訂單較以往相關期間增加。有關我們的現金流量分析及控制措施的更多詳情，請參閱本文件「財務資料－流動資金及資金資源」。相關的風險因素，請參閱本文件「風險因素－我們於2016財政年度錄得經營現金流出淨額，倘於日後繼續錄得經營現金流出淨額，可能難以履行付款責任」。

主要財務比率

	2015年／ 2015 財政年度	於12月31日 2016年／ 2016 財政年度	2017年／ 2017 財政年度
毛利率(%) ⁽¹⁾	20.5	21.0	20.9
純利率(不計及[編纂])(%) ⁽¹⁾⁽²⁾	3.5	6.9 ⁽³⁾	7.0 ⁽⁴⁾
經調整淨(虧損)／溢利率(%) ⁽¹⁾⁽²⁾	(1.4)	2.5 ⁽³⁾	5.5 ⁽⁴⁾
股本回報率(%) ⁽¹⁾	3.8	10.2 ⁽³⁾	8.9 ⁽⁴⁾
總資產回報率(%) ⁽¹⁾	1.3	3.8 ⁽³⁾	6.6 ⁽⁴⁾
利息覆蓋率(倍數) ⁽¹⁾	不適用	不適用	27.7
流動比率 ⁽¹⁾	1.2	1.6	2.5
速動比率 ⁽¹⁾	1.2	1.5	2.0
資本負債比率(%) ⁽¹⁾	162.1	147.8	15.9
淨債務權益比率(%) ⁽¹⁾	150.6	140.5	8.3

附註：

- 有關計算基準的詳情，參閱本文件「財務資料－主要財務比率」。
- 該等項目為非香港財務報告準則計量。
- 計算該比率時不計及非經常性[編纂]約[編纂]港元。倘計及於2016財政年度產生的非經常性[編纂]約[編纂]港元的影響，我們的年度溢利、純利率、股本回報率及總資產回報率將分別約為9.9百萬港元、6.3%、9.4%及3.5%。
- 計算該比率時不計及非經常性[編纂]約[編纂]港元。倘計及於2017財政年度產生的非經常性[編纂]約[編纂]港元的影響，我們的年度溢利、純利率、股本回報率及總資產回報率將分別約為2.0百萬港元、1.1%、1.4%及1.0%。

於往績記錄期間，我們的資本負債比率下降，尤其是2017財政年度大幅下降，主要歸因於持續償還銀行借款，特別是2017年7月停止現金匯集安排時。

股東資料

控股股東及主要股東

緊隨資本化發行及[編纂]完成後(不計及因根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能配發及發行的股份及假設[編纂]並無獲行使)，(i) BVI Holdings將持有本公司已發行股本約[編纂]%及被視為控股股東；及(ii)馬先生將持有本公司已發行股本約[編纂]%。

概 要

BVI Holdings由BVI Chows全資擁有，而BVI Chows由周教授及周先生分別擁有60%及40%。由於周先生及周教授通過持有彼等透過BVI Chows及BVI Holdings持有的權益共同對本公司行使控制權，故周先生、周教授、BVI Holdings及BVI Chows被假定為一組控股股東。更多詳情，請參閱本文件「與控股股東的關係」。

根據可轉換及終止契據，於可轉換貸款票據項下的權利於轉換開始日期起計六個月期間獲悉數行使後，周教授、周先生、馬先生、李先生及公眾股東於本公司的實際持股量將分別為約[編纂]%、[編纂]%、[編纂]%、[編纂]%及[編纂]%。更多詳情，請參閱本文件「歷史、重組及公司架構－簽訂可轉換及終止契據」各段。

股息

於往績記錄期間，我們並未宣派或派付任何股息。於最後實際可行日期，本集團並無任何股息政策。進一步詳情參閱本文件「財務資料－股息」。

[編纂]統計數據

[編纂]市值 ⁽¹⁾ ：	[編纂]港元至[編纂]港元
[編纂]量：	本公司經擴大已發行股本的[編纂]%
[編纂]：	每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元
[編纂]數目：	[編纂]股股份(視乎[編纂]行使與否而定)
[編纂]數目：	[編纂]股股份(可予重新分配)
[編纂]數目：	[編纂]股股份(可予重新分配及視乎[編纂]行使與否而定)
[編纂] ⁽²⁾ ：	根據[編纂]項初步提呈發售的的[編纂]最多15%

	基於[編纂] 每股[編纂]港元 ([編纂]下限)	基於[編纂] 每股[編纂]港元 ([編纂]上限)
每股未經審核備考經調整綜合 有形資產淨值 ⁽³⁾	[編纂]港元	[編纂]港元

附註：

1. 股份市值乃基於緊隨資本化發行及[編纂]完成後[編纂]股已發行股份計算。
2. 更多詳情請參閱本文件「[編纂]的架構－[編纂]」。
3. 詳情參閱本文件附錄二。

概 要

[編纂]原因及所得款項用途

半導體封裝材料行業的技術發展日新月異，需要投入大量資金及具有週期性的特點。於往績記錄期間，我們分別產生與廠房及機器、在建工程、租賃裝修以及資本化合資格開發成本有關的資金開支合共約26.6百萬港元、10.0百萬港元及16.3百萬港元。我們主要以內部產生資源及銀行借貸撥付有關資本開支。於2017年12月31日，我們的銀行借款合共為約22.7百萬港元及我們的淨債務權益比率達約8.3%。

根據弗若斯特沙利文報告，按收益計，預計2018年至2022年中國鍵合綫的市場規模將按複合年增長率約17.4%增長，而按收益計，預計同期中國半導體封裝相關封裝膠的市場規模將按複合年增長率約16.7%增長。於2017財政年度，我們的鍵合綫及封裝膠生產線的利用率分別高達約96.8%及88.7%。董事認為，落實業務策略計劃（尤其是新建生產綫、改善現有生產設施及投資研發）是我們業務可持續增長的主要推動因素，當中涉及大量資本支出，將需要大量額外財務資源。經考慮本集團的現時銀行借貸水平，董事認為，由於[編纂]為本集團的擴展計劃提供財務資源以把握中國鍵合綫及封裝膠市場的增長潛力，[編纂]對本集團業務的長期發展具有重大策略意義。

於2017年12月31日，所有銀行借款均為須於一年內償還或附帶按要求償還條款的短期借款。因此，我們須尋求其他融資來源，否則將不得不削減或暫緩資本開支或放棄商機。[編纂]將為本集團提供日後通過股權融資集資的平台，及與[編纂]前股份由私人持有時股份流動性有限相比，[編纂]將使股份可於聯交所自由買賣，提升股份的流動性。董事認為，[編纂]地位可提升本集團於銀行的信譽等級，有助於按更具競爭力的條款滿足未來融資需求。

基於[編纂]每股[編纂][編纂]港元（即指示性[編纂]範圍的中位數），自[編纂]所得款項總額中扣除本公司已付或應付的估計[編纂]佣金及總開支合共約[編纂]港元後及假設[編纂]未獲行使，根據[編纂]發行[編纂]的所得款項淨額估計約為[編纂]港元。我們擬按以下方式應用根據[編纂]發行[編纂]的所得款項淨額：

- 所得款項淨額約[編纂]%或[編纂]港元用作(i)再建立兩條鍵合綫生產綫；(ii)繼續添置及改造封裝膠的生產設施；及(iii)加強生產流程的質量控制；

概 要

- 所得款項淨額約[編纂]%或約[編纂]港元用作(i)通過購買機器及設備改善現有研發設施；及(ii)自兩所大學委聘外部顧問進行10個涉及新產品及應用、原材料及生產技術的項目研發，每個項目的平均合約金額為約[編纂]港元；
- 所得款項淨額約[編纂]%或約[編纂]港元用於銷售及營銷活動以推廣產品及提升公司形象；及
- 所得款項淨額約[編纂]%或約[編纂]港元將用作一般營運資金。

進一步詳情參閱本文件「業務目標陳述及所得款項用途」。

[編纂]

假設每股[編纂]的[編纂]為[編纂]港元（即指示性[編纂]範圍的中位數）及[編纂]未獲行使，則[編纂]總額估計將約為[編纂]港元，其中約[編纂]港元直接因發行新股份而產生，並將入賬列作自權益扣減入賬，而餘下約[編纂]港元已經或將於綜合損益及其他全面收益表反映。其中，約[編纂]港元及[編纂]港元已分別於2016財政年度及2017財政年度的損益賬扣除，而預計餘下金額約[編纂]港元將於2018財政年度的綜合損益及其他全面收益表確認。將於本集團損益內確認的該等款項的最終數額將根據審核及變量及假設變動予以調整。有意投資者應注意，本集團於2018財政年度的財務業績將受到上述非經常性[編纂]的不利影響，且未必能與本集團過往的財務表現比較。

近期發展及重大不利變動

於往績記錄期間之後及直至本文件日期，我們的業務模式、收益結構及成本結構基本保持不變。於2018年3月31日，根據我們於2017年11月就銷售我們的產品與若干現有及潛在客戶訂立的不具法律約束力的諒解備忘錄，該等客戶(i)將於2018年下達約235,900千米的鍵合綫及約128,300公斤的LED封裝硅膠及LED環氧樹脂的指示性採購訂單；及(ii)將於2019年下達約338,400千米的鍵合綫及約199,200公斤的LED封裝硅膠及LED環氧樹脂的指示性採購訂單，我們實現的實際銷量及接獲新採購訂單金額合共約11.5百萬港元。

概 要

除[編纂]對本集團綜合損益及其他全面收益表以及對本集團自2017年12月31日以後的財務或貿易狀況或前景造成重大不利影響外，董事確認，直至本文件日期，自2017年12月31日以後，本集團的財務或貿易狀況並無重大不利變動，且自2017年12月31日以後，並無發生將會對會計師報告(全文載於本文件附錄一)所示資料造成重大影響的事件。

競爭格局

中國的半導體封裝材料行業競爭激烈且高度分散。於鍵合綫板塊，於2017年，中國有約250至280名鍵合綫供應商，而行業由國際及外國行業參與者主導。然而，中國國內鍵合綫製造商開始嶄露頭角及預期會逐漸佔據更多市場份額。相較而言，中國封裝膠行業的競爭更為激烈，於2017年，市場上有逾2,100名參與者及大部分市場參與者為中小規模製造商。進一步詳情參閱本文件「行業概覽」。

違規事項

於往績記錄期間，本集團未能遵守與物業租賃協議有關的若干中國法律規定。參閱本文件「業務－物業」。

風險因素

任何投資均涉及風險。有關本集團的部分相對重大風險包括：

- 我們的表現取決於客戶所從事行業以及其終端產品的需求
- 我們的競爭力取決於我們的研發成果或表現以及我們緊跟技術發展步伐及洞悉最新市場趨勢及要求的能力
- 我們未來可能無法有效管理增長及擴充
- 我們發展及升級生產設施的計劃可能導致財務業績波動，且擴充生產設施未必能達致預期的盈利能力，甚至根本無法達致
- 我們並無與客戶訂立長期協議，無法保證我們的銷量將保持穩定。此外，我們面臨客戶的信貸風險。

有關所有風險因素的詳細討論載列於本文件「風險因素」一節，投資者於決定投資[編纂]前務請閱讀整節。